

PK66X 高纯数字压力开关

产品认证

CE RoHS

应用场景

- 

半导体光伏
- 

超纯环境
- 

腐蚀性介质
- 

配气系统



产品特性

密封	测试	包装	表面处理
9/16-18UNF、 C/W-Seal、穿流式	100%氦泄露测试	百级洁净室内真空 包装	过程连接处EP级为 Ra≤0.18μm

产品描述

此产品全金属焊接结构，可选择半导体光伏专用压力接头，接液表面100%特殊EP处理，并脱脂无油清洗，充分满足半导体、光伏、平板显示器、高纯/超纯环境、特殊气体管道等应用。

压力范围覆盖-14.7~6000psi，且量程可以任选，满足客户特殊要求。

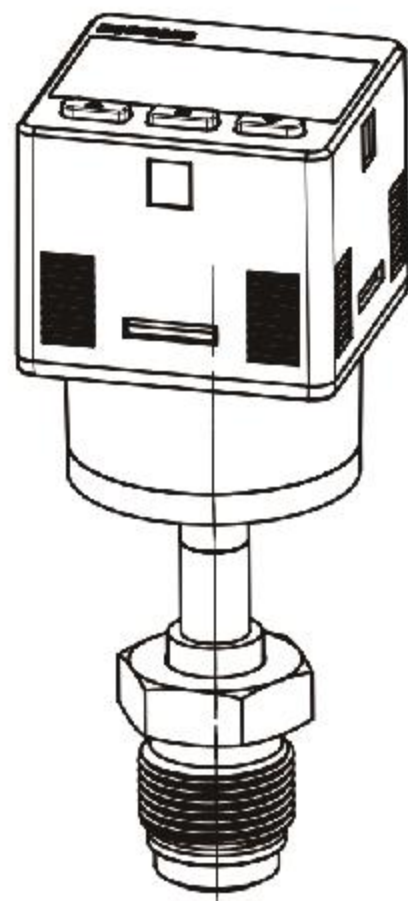
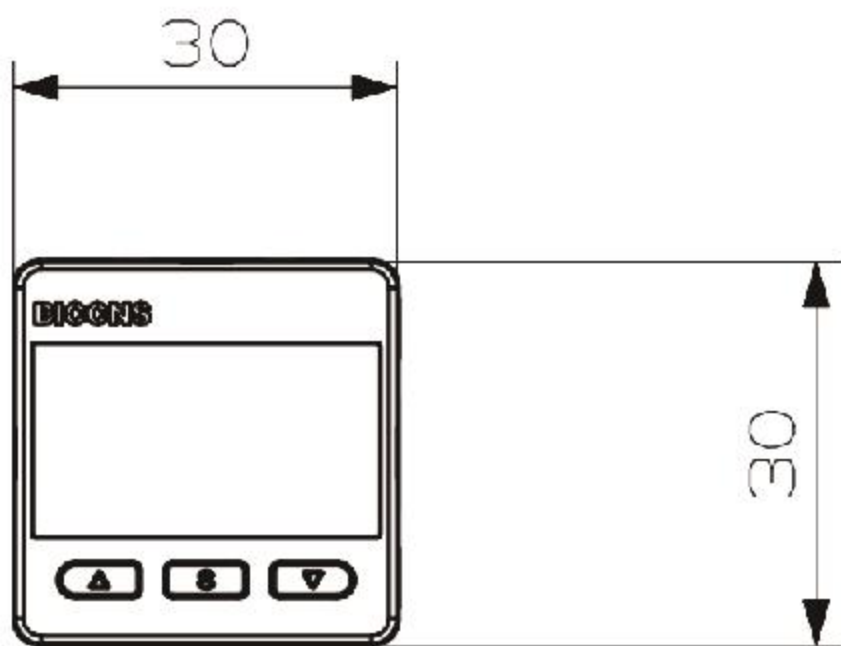
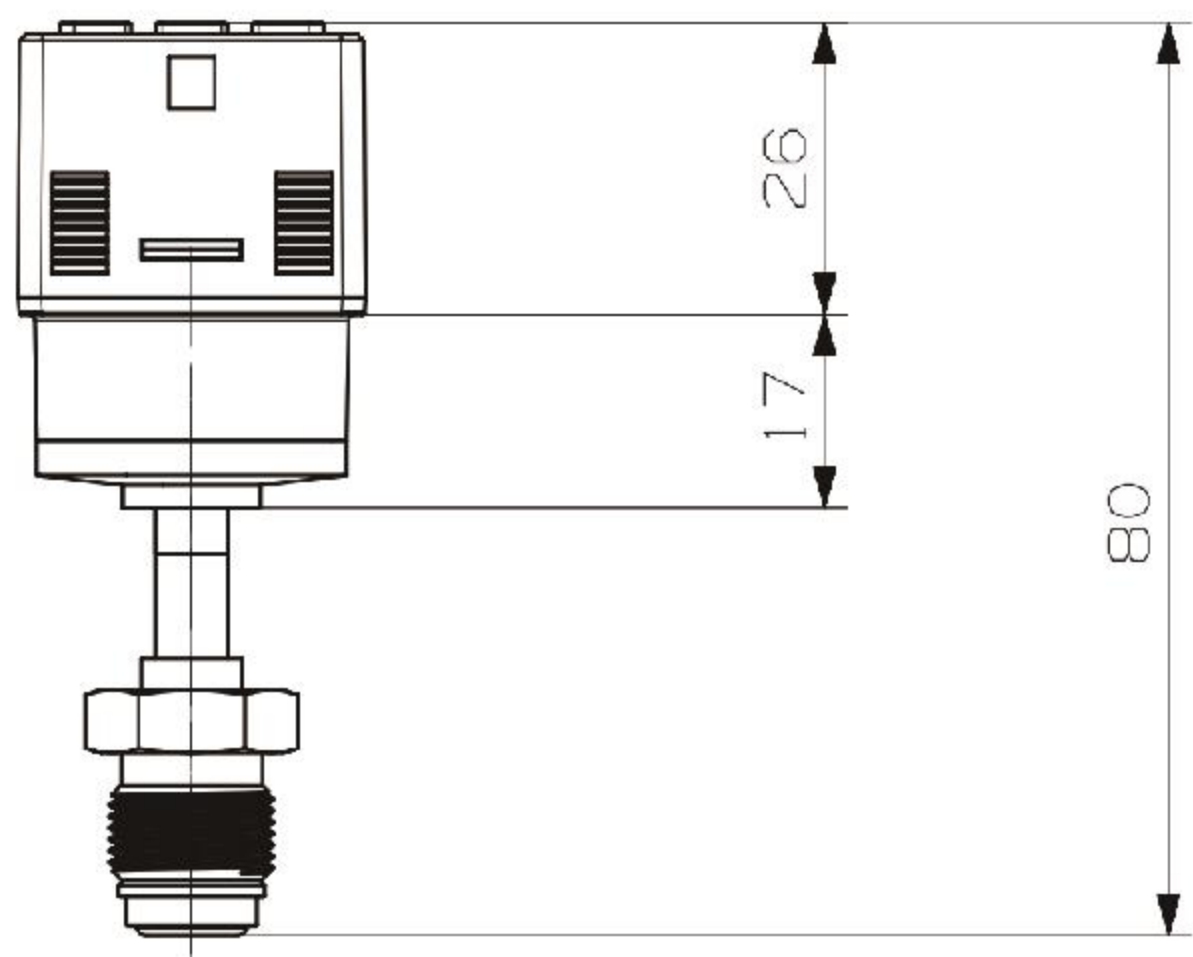
产品生产100%泄露测试，满足行业密封要求，避免易燃易爆、腐蚀或有毒介质溢出风险。

产品全程在百级洁净室生产并真空包装，同时100%清洗，满足SEMI标准需求。

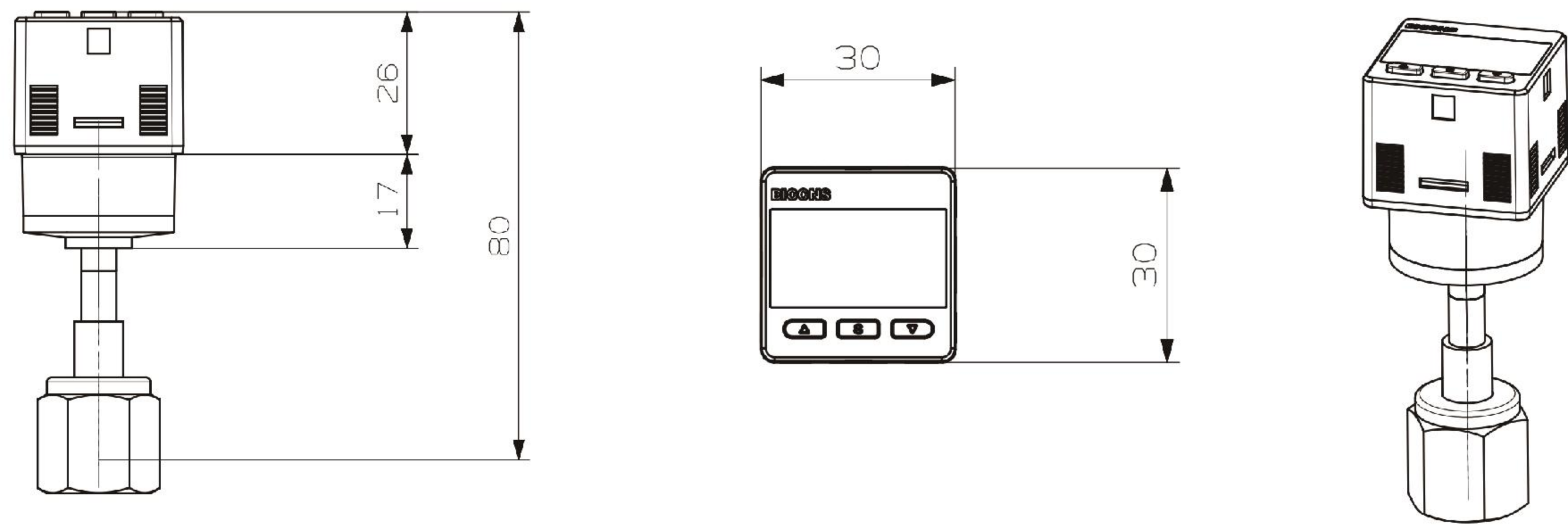
技术参数

应用场合	表压、绝压、负压测量
测量量程	-14.7.....0.....6000psi
精度等级（@25℃）	≥160psi: ±0.1%FS BFSL; < 160psi: ±0.15%FS BFSL
最大测量偏差（@25℃）	±0.25%FS（< 160psi: ±0.5%FS）
过载压力	最大4倍
介质温度	-20.....85° C
环境温度	-40.....125° C
平均温度系数（-20~85℃）	零点: <0.1%FS/10K; 量程: <0.1%FS/10K
供电电压	DC24V（10...30 V DC）
输出信号	4...20mA、0...5V、0...10V、1...5V
开关点	PNP*2或者NPN*2
连接材质	SUS316L / 316L VIM/VAR
膜片材质	SUS316L VIM/VAR/ 镍基合金
稳定性能	典型值: 0.1%FS/Year
泄露率	≤ 1 X 10 ⁻¹⁰ kPa.l/s
包装	真空双层包装, 符合SEMI E49.6

规格尺寸（单位：mm）

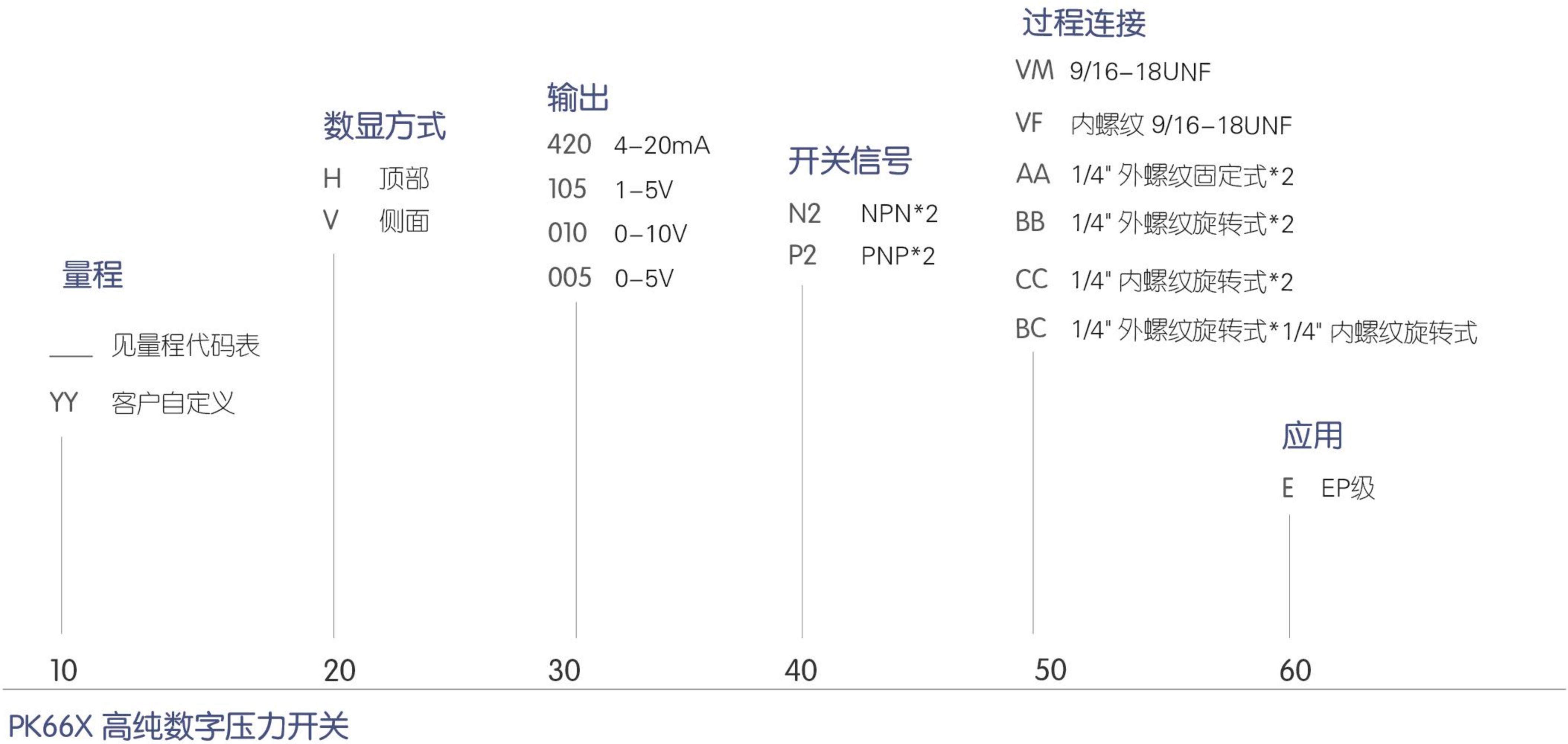


顶部数显 9/16-18UNF 外螺纹



顶部数显 9/16-18UNF 内螺纹

量程代码表					
选型代码	量程范围MPa	量程范围Bar	选型代码	表压范围MPa	表压范围Bar
BG200K	(-0.1~0.2)	(-1~2)	G200K	(0~0.2)	(0~2)
BG300K	(-0.1~0.3)	(-1~3)	G300K	(0~0.3)	(0~3)
BG500K	(-0.1~0.5)	(-1~5)	G500K	(0~0.5)	(0~5)
BG700K	(-0.1~0.7)	(-1~7)	G700K	(0~0.7)	(0~7)
BG1M	(-0.1~1)	(-1~10)	G1M	(0~1)	(0~10)
BG2M	(-0.1~2)	(-1~20)	G2M	(0~2)	(0~20)
BG3.5M	(-0.1~3.5)	(-1~35)	G3.5M	(0~3.5)	(0~35)
BG5M	(-0.1~5)	(-1~50)	G5M	(0~5)	(0~50)
BG10M	(-0.1~10)	(-1~100)	G10M	(0~10)	(0~100)
BG20M	(-0.1~20)	(-1~200)	G20M	(0~20)	(0~200)



选型规则：

需求: 4-20mA输出+PNP*2、-0.1~0.5MPa、顶部数显、9/16-18UNF外螺纹、EP级

选择型号：PK66X-BG500KH420P2VME